

微电子焊接与封装



作者：金德宣，张晓梅编著

出版社：成都：电子科技大学出版社

出版日期：1996. 11

总页数：152

说明：登录教客网 (<https://www.jiaoke.com/book/detail/10202426.html>) 查找全本阅读方式

微电子焊接与封装 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/10202426.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/10202426.html>

书名：微电子焊接与封装